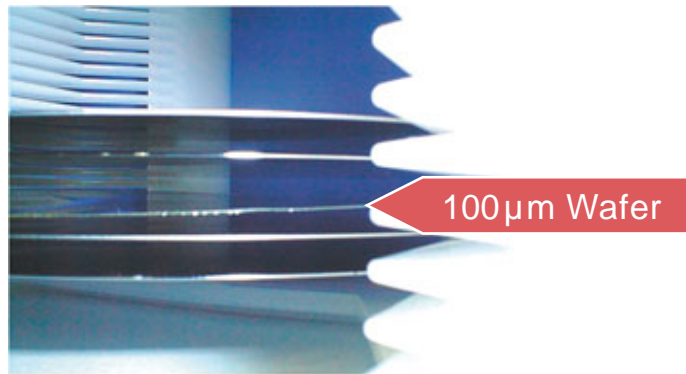


アルバックの極薄ウェーハ技術

1. 長い経験と豊富な実績。
2. 50 μ m厚さ(6インチ)までの自動搬送に成功。
3. サポート付き(WSS)ウェーハでもプロセスが可能。
4. WSS付きウェーハにも対応可能な静電チャック。
5. 機種間(インプラ、スパッタ、エッチ)で搬送系の共通化。

極薄ウェーハ

厚 さ : 150 μ m ~ 50 μ m
 サイズ : 125mm , 150mm , 200mm



極薄ウェーハの市場

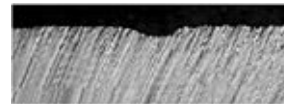
パワーデバイス、スマートカード、
積層パッケージ、etc.

自動搬送での課題

ウェーハの反り



チッピングが多い
(形状バラツキが多い)



強度が低い(もろい)

プロセスでの課題

プロセス中の基板 ... 温度上昇

自動搬送ソリューション

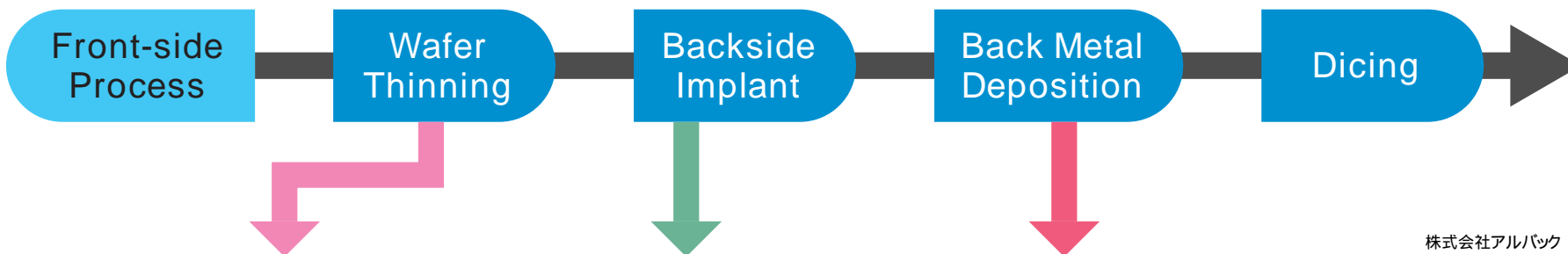
反りの影響を低減する
 ・特型カセット
 ・ロボットハンド
 チッピングウェーハも対応可能
 ・高精度オリフラ合せ
 ウェーハの動きを抑えた
 ・ロードロック室

プロセスソリューション

冷却能力の高い
 ・静電チャック

Tape Support	Tape Thickness: 200-300 μ m Applicable Wafer: >100 μ m
Glass Support	Glass Thickness: Various Applicable Wafer: <100 μ m Adhesive Material: Various

プロセスフロー



株式会社アルバック



<p>イオン注入装置</p>	<p>ウェーハサイズ : 125mm ,150mm 厚さ : 50μm ~ 150μm 15 台以上</p>
-----------------------	--

<p>スパッタ装置</p>	<p>ウェーハサイズ : 125mm ~ 200mm 厚さ : 50μm ~ 150μm 20 台以上</p>
----------------------	---